

2013 年度精密工学会春季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 平成 25 年 3 月 13 日（水）～15 日（金）
2. 会 場 東京工業大学 大岡山キャンパス（東京都目黒区大岡山 2-12-1）
3. 講演申込開始 平成 24 年 11 月 9 日（金）9 時から
4. 講演申込締切 平成 24 年 12 月 1 日（土）17 時まで
5. 講演論文原稿締切 平成 25 年 1 月 11 日（金）17 時まで
6. 講演申込費締切日 平成 25 年 2 月 28 日（木）までにお納めください。
7. 講演論文公開予定 平成 25 年 2 月 27 日（水）（講演論文集 CD-ROM 発行）
8. 登壇資格
 - ・ 個人会員（正会員・学生会員・学生会員 Web 級・名誉会員）、賛助会員所属の非個人会員および非会員の方の登壇が可能です。
 - ・ 登壇者を代表に申し込んでいただきますが、講演原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 講演申込について

- 1) 登壇者のお名前でご受け付けます。講演費用の請求、郵送物の送付は登壇者に行います。また、WEB へのアクセスも登壇者に限りますので、お申込後にやむを得ず登壇者を変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。
- 2) 講演申込みは、すべて精密工学会ホームページから行っていただきます。講演申込締切期日を厳守してください。締切後直ちにプログラム編成を行いますので、遅れたものは理由を問わず受け付けません。なお、精密工学会ホームページには講演募集に関する最新情報を掲載します。
- 3) 申込先
<http://www.jspe.or.jp/>（精密工学会ホームページ）
 （問合せ先）公益社団法人 精密工学会 大会係
 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9 九段誠和ビル 2 階
 電話：03-5226-5191, E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp
- 4) 講演申込みは 1 件につき 1 通登録してください。
- 5) 講演申込みには下記の費用が必要です。（費用はすべて税込です）

登壇者会員区分	申込件数	講演費	備考
正会員	1 件目	10000 円	登壇者の大会参加費、講演論文集 CD-ROM、アブストラクト集含む
	2 件目以降	5000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合、1 件ごとに講演費が必要です
学生会員・学生会員 Web 級	1 件目	5000 円	登壇者の大会参加費、アブストラクト集含む ※講演論文集 CD-ROM は別途ご購入ください。
	2 件目以降	5000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合、1 件ごとに講演費が必要です
賛助会員に所属する非個人会員	1 件目	15000 円	登壇者の大会参加費、講演論文集 CD-ROM、アブストラクト集含む
	2 件目以降	10000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合、1 件ごとに講演費が必要です
非会員	1 件目	15000 円	登壇者の大会参加費、講演論文集 CD-ROM、アブストラクト集含む
	2 件目以降	10000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合、1 件ごとに講演費が必要です
学生非会員	1 件目	10000 円	登壇者の大会参加費、アブストラクト集含む ※講演論文集 CD-ROM は別途ご購入ください。
	2 件目以降	8000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合、1 件ごとに講演費が必要です

送金方法：郵便振替・銀行振込・現金書留

郵便振替：00180-3-6115 公益社団法人 精密工学会

銀行振込：みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788 公益社団法人 精密工学会

- 6) 講演論文原稿は、PDF 原稿の書き方を参考に作成し、原稿締切日までに指定の WEB ページから提出してください。
- 7) 講演論文集および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。
- 8) 講演論文集 CD-ROM に収録された論文の著作権およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権、翻案権、翻訳権を含みます。

10. 講演申込の方法

- 1) 講演申込は、精密工学会ホームページでフォームに沿って登録してください。
- 2) 同一題目の第 1 報～第 n 報には必ず副題を入れてください。
- 3) 講演要旨はそのままアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を 200 字以内で書いてください。
- 4) 分類・コードの入力について
 プログラム分類・コード・キーワードを別紙一覧表の通り設定しました。このキーワードはあくまでもセッションを構成するための「セッションキーワード」です。文献検索用のキーワードではありませんので、ご理解ください。
 オーガナイズドセッションに申し込みをする場合は、希望するセッションに指定された分類・コードを所定欄に必ず入力してください。最近、分類・コードの入力ミスの原因とするプログラム変更が増えております。入力漏れ、入力ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。オーガナイズドセッションに適切なものがない場合は分類のみを指定し、コードは「99」と入力してください（一般セッション）。

11. プログラムについて

プログラム編成は、その編成権を学術交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になることがありますので、あらかじめご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。

12. 講演発表に関するお願いと注意

- 1) 同一講演者（同一登壇者）が同一テーマ種別で 3 件以上の講演はご遠慮ください。
- 2) 同一題目で 3 件以上の講演はご遠慮ください。
- 3) 講演で使用可能な機器はプロジェクタです。

〈プロジェクト使用の方へ〉

パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演のセッション開始前にお願いします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、登壇者の責任で対処していただくようお願いします。

13. 登壇者変更および講演申込の取消について

- 1) 講演申込時の題目・登壇者の変更は原則として認めません。やむを得ず変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡のない場合は、講演申込時の題目・登壇者情報をプログラムに記載いたします。
- 2) 講演申込締切日を過ぎても申込キャンセルは原則として認めません。必ず講演論文を提出し発表を行っていただきます。登壇者が病気や事故等のやむを得ない理由で発表できない場合は、連名者が代わりに発表するものとします。この点については、講演申込の前に、連名者に必ずご確認ください。

14. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

特に優れた講演発表について「ベストプレゼンテーション賞」を講演者にお出しします。本賞の審査ならびに選考方法については、別途、お知らせいたします。

2013年度精密工学会春季大会学術講演会セッション一覧

<分類表>

A: 設計・生産システム B: 加工技術・材料 C: メカトロニクス・知的システム
D: 計測・品質管理 E: 医用・福祉工学 F: 技術史・教育 G: 新領域, その他 H: International Session

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
A	01	OS	形状モデリングの基礎と応用	大竹 豊(東京大), 金井 崇(東京大)	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	OS	デジタルスタイルデザイン	小林 一也(富山県大), 青山 英樹(慶應義塾大)	意匠設計(スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	OS	生産システムのエンジニアリング(基礎・理論)	樋野 励(名古屋大), 荒井 栄司(大阪大), 藤井 信忠(神戸大)	スケジューリング, 工程計画, 新生産システム概念
A	04	OS	生産システムのエンジニアリング(応用・実践)	日比野 浩典(機振協 技研), 谷水 義隆(大阪府立大), 光行 恵司(デンソー)	生産システム設計・評価, サプライチェーン, デジタルファクトリー, 企業導入事例
A	05	OS	持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	高田 祥三(早稲田大), 梅田 靖(大阪大), 増井 慶次郎(産総研)	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニュファクチャリング
A	06	OS	設計の方法論(製品, サービス, PSS)	下村 芳樹(首都大), 妻屋 彰(神戸大), 藤井 信忠(神戸大), 野間口 大(大阪大)	製品, サービス, PSS
A	07	OS	デジタルエンジニアリング	小林 正和(豊田工大), 西脇 眞二(京都大), 泉井 一浩(京都大)	モノづくり, 最適化, 設計生産
A	08	OS	マイクロ生産機械システム	岡崎 祐一(産総研), 木村 広幸(湘南工科大)	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立
A	09	OS	サイバーフィールド構築技術	増田 宏(東京大), 金井 理(北海道大), 小野里 雅彦(北海道大)	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	99	一般	設計・生産システム一般		
B	01	OS	工作機械の高速高精度化	白瀬 敬一(神戸大), 松原 厚(京都大), 森本 喜隆(金沢工大), 家城 淳(オークマ)	工作機械, 高速主軸, 高速送り, 高速高精度制御
B	02	OS	高能率・高精度化のための切削工具	臼杵 年(島根大), 新谷 一博(金沢工大), 關谷 克彦(広島大)	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	OS	多軸制御加工計測	竹内 芳美(中部大)	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄(九州大)	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	OS	超精密マイクロ機械加工	竹内 芳美(中部大), 社本 英二(名古屋大), 鈴木 浩文(中部大), 閻 紀旺(慶應義塾大)	超精密加工, 微細加工, 超精密工作機械
B	06	OS	エコマシニング技術	中村 隆(名古屋工大), 酒井 克彦(静岡大)	エコマシニング, 環境対応生産, 環境負荷低減技術
B	07	OS	金型設計・生産技術	鈴木 裕(九州工大)	金型用CAD/CAM, 高速高精度加工, 新加工技術, 金型加工技術, 高硬度材加工
B	08	OS	超音波振動を援用した加工技術	神 雅彦(日本工大), 磯部 浩己(長岡技科大)	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	09	OS	研削現象とその機構	大橋 一仁(岡山大), 坂本 治久(上智大)	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	10	OS	超砥粒ホイール応用加工技術の新展開	市田 良夫(宇都宮大), 田辺 実(明治大), 澤 武一(東京電機大)	超砥粒ホイール, ツルーイング・ドレッシング, 研削盤, 超砥粒ホイール応用加工技術
B	12	OS	曲面・微細形状・機能性材料の超精密加工と計測	鈴木 浩文(中部大), 山形 豊(理化学研), 林 偉民(群馬大), 森田 晋也(理化学研)	曲面・微細加工, 機能性材料, 超精密加工, 超精密計測
B	13	OS	ナノ表面研削/ELID研削	大森 整(理化学研), 林 偉民(群馬大), 伊藤 伸英(茨城大), 上原 嘉宏(理化学研), 水谷 正義(東北大)	ナノ精度, 鏡面研削, ELID研削
B	14	OS	切断加工	坂本 智(横浜国大), 諏訪部 仁(金沢工大)	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	15	OS	砥粒加工の新展開	榎本 俊之(大阪大), 北嶋 弘一(関西大)	ポリッシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	16	OS	複合研磨	郷 艶華(宇都宮大), 川久保 英樹(信州大), 赤上 陽一(秋田県産業技術センター)	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	17	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	近藤 誠一(日立化成工業), 黒河 周平(九州大), 畷田 道雄(金沢工大)	CMP, プラナリゼーション, 超精密研磨, スラリー, 半導体材料

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
B	18	OS	電気エネルギー応用加工	武沢 英樹(工学院大), 早川 伸哉(名古屋工大)	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	19	OS	レーザー加工	池野 順一(埼玉大), 徳永 剛(千葉大)	レーザー加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	20	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	諸貫 信行(首都大), 森田 昇(千葉大), 梅原 徳次(名古屋大)	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
B	21	OS	表面処理・機能薄膜	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 安武 潔(大阪大), 大竹 尚登(東京工大)	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
B	22	OS	ナノ・マイクロ加工シミュレーション	武澤 伸浩(名古屋工大), 田中 宏明(大阪電気通信大)	加工プロセスのシミュレーション
B	23	OS	ナノ精度表面創成法とその応用	三村 秀和(東京大), 久保田 章亀(熊本大), 大橋 治彦(高輝度光科学研究センター), 山村 和也(大阪大)	超精密研磨, 超精密形状計測, 超精密研削, 非球面光学素子, 次世代半導体基板
B	24	OS	エンドミル加工技術	安齋 正博(芝浦工大), 吉川 浩一(九州工大), 松村 隆(東京電機大), 岩部 洋育(新潟大)	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション
B	25	OS	機能形状創製 (Additive ManufacturingとMID)	新野 俊樹(東京大)	Additive Manufacturing, MID
B	99	一般	加工技術・材料一般		
C	01	OS	精密・超精密位置決め	佐藤 海二(東京工大), 佐藤 隆太(神戸大), 真崎 和生(ニコン)	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	OS	転がり機械要素	野口 昭治(東京理科大), 下田 博一(明治大), 清水 茂夫(明治大)	転がり機械要素, 転がり接触, 転がり疲れ, 転がり軸受, ボールねじ, ボールガイド, 信頼性
C	03	OS	新原理アクチュエータとその応用デバイス	古谷 克司(豊田工大), 岩附 信行(東京工大)	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ
C	04	OS	マイクロ/ナノシステム	堀江 三喜男(東京工大), 大平 文和(香川大), 伊藤 高廣(九州工大), 中里 裕一(日本工大)	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS
C	05	OS	MEMS商業化技術	高木 秀樹(産総研), 日暮 栄治(東京大), 生津 資大(兵庫県立大), 小久保 光典(東芝機械)	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント
C	06	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	青村 茂(首都大), 山本 雅人(北海道大), 林 朗弘(九州工大)	群知能, 進化と学習, 自律分散, 複雑システム
C	07	OS	ロボティクス	小方 博之(成蹊大), 青柳 誠司(関西大), 関 啓明(金沢大)	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	08	OS	メカトロニクス	佐々木 健(東京大)	
C	99	一般	メカトロニクス・知的システム一般		
D	01	OS	メカノフォニクス	北川 克一(東レエンジニアリング), 水谷 康弘(徳島大), 稲 秀樹(キヤノン)	光応用技術, 形状計測, オプトメカトロニクス
D	02	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	有馬 健太(大阪大), 岩田 太(静岡大), 桑原 裕司(大阪大), 遠藤 勝義(大阪大)	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
D	03	OS	知的精密計測	高増 潔(東京大), 笹島 和幸(東京工大), 高谷 裕浩(大阪大), 高 偉(東北大)	知的計測
D	04	OS	画像技術と産業システム応用	清水 毅(山梨大), 菅野 純一(ヴィスコ・テクノロジーズ)	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	99	一般	計測・品質管理一般		
E	01	OS	医用・人間工学	佐久間 一郎(東京大), 垣本 映(職能開発総合大), 太田 裕治(お茶の水女子大)	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	99	一般	医用・福祉工学一般		
F	01	OS	生産原論	伊藤 昌樹(関東職能開発大), 河西 敏雄(埼玉大/河西研磨技術特別研究室), 伊藤 伸英(茨城大), 池野 順一(埼玉大)	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承
F	99	一般	技術史・教育一般		
G	99	一般	新領域・その他		
H	99	一般	International Session	精密工学の分野全体を対象とした英語講演を募集するもので, 英語のみのセッションです.	